

多芯片组装模块(MCM)的测试技术项目风险评估报告

目录

序言.....	3
一、安全评价程序与评价方法.....	3
(一)、安全评价程序.....	3
(二)、划分评价单元.....	4
(三)、确定采用的安全评价方法.....	6
二、环境评价.....	8
(一)、环境评价概述.....	8
(二)、评价多芯片组装模块(MCM)的测试技术项目概况.....	8
(三)、环评单位的基本情况.....	10
(四)、评价范围及目的.....	11
(五)、评价依据.....	13
(六)、国家环保法律法规.....	13
(七)、地方环保规定.....	13
(八)、相关标准和技术规范.....	14
(九)、评价程序与方法.....	14
(十)、环境评价程序.....	14
(十一)、评价方法与技术路线.....	16
三、对策措施与建议.....	17
(一)、事故隐患的整改措施.....	17
(二)、建议的安全对策措施.....	18
四、危险、有害因素的辨识与分析.....	19

(一)、辨识与分析危险、有害因素的依据.....	19
(二)、主要危险、有害物质分析.....	20
(三)、生产过程中危险有害因素的辨识与分析.....	22
(四)、自然条件危险、有害因素辨识与分析.....	23
(五)、安全管理不当导致的危险、有害因素辨识与分析.....	25
(六)、重大危险源辨识结果.....	27
五、资源合理利用.....	28
(一)、能源利用.....	28
(二)、水资源利用.....	30
(三)、土地资源利用.....	31
(四)、原材料资源利用.....	33
(五)、其他资源的合理利用.....	34
六、节能减排措施.....	35
(一)、节能措施.....	35
(二)、减排措施.....	37
(三)、清洁生产措施.....	39
七、环境风险评估.....	40
(一)、环境风险评估概述.....	40
(二)、评价多芯片组装模块(MCM)的测试技术项目风险分析.....	41
(三)、风险应急预案.....	44
八、社会影响评估.....	46
(一)、社会经济状况.....	46

(二)、多芯片组装模块(MCM)的测试技术项目对当地经济的影响.....	48
(三)、多芯片组装模块(MCM)的测试技术项目对当地社会的影响.....	49
(四)、多芯片组装模块(MCM)的测试技术项目对当地文化的影响.....	51
九、多芯片组装模块(MCM)的测试技术项目安全现状评价报告的存档与发布.....	53
(一)、存档程序.....	53
(二)、存档内容.....	55
(三)、存档地点.....	55
(四)、报告发布.....	55
十、安全生产与环境保护培训.....	56
(一)、培训计划.....	56
(二)、培训内容.....	60
(三)、培训方法.....	62
(四)、培训效果评估.....	64
十一、安全与环境问题的沟通与协调.....	65
(一)、内部沟通机制.....	65
(二)、外部协调与社会沟通.....	67
(三)、危机公关处理.....	69
十二、安全与环境考核评价.....	70
(一)、考核制度.....	70
(二)、考核内容.....	72
(三)、考核方法.....	74
(四)、考核结果分析.....	76

(五)、考核奖惩措施.....	78
十三、多芯片组装模块(MCM)的测试技术项目安全现状评价报告的审核与批准	80
(一)、审核程序与内容	80
(二)、审核人员.....	81
(三)、审核结论	83
(四)、报告批准程序.....	84

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/046241214105010130>